

# Mate 2007 第13回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」 シンポジウム《人間の安全・快適さを支援するものづくりを考える》参加者募集

**主催：**(社)溶接学会 マイクロ接合研究委員会  
**共催：**(社)機械学会 エレクトロニクス実装における信頼性設計に関する研究分科会，(社)高温学会 加工・再生研究情報委員会，(社)日本塑性加工学会 接合・複合分科会，(社)日本電気制御機器工業会，エレクトロニクス生産科学学会準備会，レーザ加工学会，大阪大学 先端科学イノベーションセンター  
**協賛：**映像情報メディア学会，エレクトロニクス実装学会，応用物理学会，化学工学会，画像電子学会，軽金属学会，計測自動制御学会，高温学会，高分子学会，資源・素材学会，システム制御情報学会，情報処理学会，精密工学会，電気化学会，電気学会，電気設備学会，電子情報通信学会，日本機械学会，日本金属学会，日本材料学会，日本シミュレーション学会，日本接着学会，日本セラミックス協会，日本塑性加工学会，日本顕微鏡学会，日本伝熱学会，日本非破壊検査協会，日本表面科学会，日本品質管理学会，日本複合材料学会，日本物理学会，日本分析化学会，日本溶接協会，表面技術協会，プラスチック成形加工学会

## 開催趣旨

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションが必要になってきています。本シンポジウムでは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

**日時：**平成19年2月1日(木) 8:50～17:10  
平成19年2月2日(金) 9:00～17:30

**会場：**パシフィコ横浜 会議センター  
5階(小ホール，501，502)

横浜市西区みなとみらい1丁目1-1  
TEL: 045-221-2121

## シンポジウム参加登録費(論文集代を含む)

- 主催・共催団体登録会社 : 20,000円
- 溶接学会，協賛学協会会員会社 : 30,000円
- 論文口頭発表者 : 15,000円
- 大学・国公立研究機関 : 10,000円
- 学生 : 5,000円
- その他(一般) : 40,000円

## シンポジウム参加申し込み方法

所定の用紙に必要事項(申込者氏名，連絡先住所，電話番号，FAX番号など)を記入し，次の申込先にお申し込み下さい。受付次第，参加受付書を返送させていただきます。参加登録料は，現金書留，郵便振替，銀行振込のいずれかでお支払い下さい。

問合せ，申込先：(社)溶接学会 Mate 2007 事務局  
担当連絡先：TEL: 080-6147-2116，FAX: 06-6879-4166

E-Mail: mate@casi.osaka-u.ac.jp

**参加申し込み締め切り日：**平成19年1月22日(月)

**振込先銀行：**三井住友銀行 江坂支店  
口座番号：普通 No.1217052  
口座名義：Mate 実行委員会 藤本公三

## シンポジウム URL

<http://www.soc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2007.html>

## プログラム(セッション名と発表件数)

2月1日(木) 8:50～17:10 (17:30～懇親会)

### ◆プレナリーセッション

「電気製品の事故実態と原因分析」

((独)製品評価技術基盤機構 堀越秀夫)

「安全・安心な社会構築への人間中心設計の果たす役割」

(大阪市立大学 岡田 明)

「設計者に望まれるものづくり安全に関する見識とグ

ローバルに進化する安全技術と国際規格の動向」

((社)日本電気制御機器工業会 制御安全委員会

委員長 (IDEC(株) 常務執行役員))

**2月1日（木）8:50～17:10**

- A-1 マイクロ接合（4件）
- A-2 バンプ実装（5件）
- A-3 レーザー加工・接合（4件）
- B-1 鉛フリーⅠ 材料特性・組織（5件）
- B-2 鉛フリーⅡ 接合信頼性（5件）
- B-3 鉛フリーⅢ 疲労・熱疲労特性（4件）

**2月2日（金）9:00～17:00**

- A-4 開発（5件）
- A-5 樹脂材料・プリント配線板 界面反応（5件）
- A-6 モジュール・光導波路（4件）
- A-7 微細配線（4件）
- B-4 鉛フリーⅣ 腐食・溶解（5件）
- B-5 イオンマイグレーション・ウィスカ（5件）
- B-6 熱疲労信頼性（4件）
- B-7 機械的信頼性（5件）

（一般論文発表合計64件）